

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>副总经理、董事会秘书：蒋威 证券投资部：陈小曼、陈卓璜</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>一、公司2024年度及2025年第一季度业绩情况介绍</p> <p>2024年度，公司实现营业收入581,732.42万元、同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润-19,828.98万元、同比下降193.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,576.85万元、同比下降509.87%。总资产1,366,827.72万元、较上年末下降8.48%；归属于上市公司股东的净资产493,548.69万元、较上年末下降7.47%。</p> <p>报告期内，受益于行业复苏，公司营业收入保持平稳增长，净利润为负，是公司上市以来首年亏损。从非经营性层面来看，参股公司锐骏半导体的公允价值变动损失、递延所得税资产冲回及资产减值合计影响超2亿元。经营性层面主要是受FCBGA封装基板业务费用投入高、子公司宜兴硅谷和广州兴科亏损拖累，其中，FCBGA封装基板项目整体费用投入73,403.58万元，宜兴硅谷因客户和产品结构不佳、以及竞争激烈导致产能未能充分释放，亏损13,170.17万元，广州兴科CSP封装基板项目因产能利用率不足导致亏损7,070.08万元。</p> <p>2025年第一季度实现营业收入157,960.38万元、较上年同期增长13.77%，归属于上市公司股东的净利润为937.24万元，扣非归母净利润690.00万元。PCB行业2025年一季度整体形势有进一步好转，公司一季度营收也取得自上市以来单季度历史新高的成绩，环比实现扭亏。</p> <p>二、行业情况简介</p> <p>2024年以来，全球PCB行业呈现结构分化的弱复苏态势。根据Prismark报告，预计2024年产值为735.65亿美元、同比增长5.8%。从下游看，与AI、汽车电动化智能化相关的领域表现好，消费电子弱复苏，通信行业下滑，工业和医疗平稳增长。整体而言，服务器、交换机、光模块是表现最好的细分领域。</p> <p>从产品结构看，18层及以上高多层板（同比增长约40%）、HDI（同比增长约18.8%）是表现最好的细分子行业，主要受AI、网通、卫星通信拉动，我们判断也是2025年表现最好的细分领域。封装基板行业同比增长0.8%，整体表现为需求不足，行业最差的时候已经过去，2025年会进一步</p>

回暖，BT载板会比ABF载板表现略好。根据公开信息，台湾载板厂商（欣兴电子、景硕科技）2024年营业收入平均增长幅度约10%，营收规模较2022年行业高点下滑约20%左右，2025年一季度进一步回暖，营收规模及增速同比显著回升。常规多层板市场整体表现为供给过剩、内卷加剧，量增价跌，尤其是国内市场。

从区域市场看，美国市场表现好，国防、航空航天行业表现较好；中国市场量增价跌；东南亚市场表现次之，因为高多层PCB和HDI市场火爆，以及大量的中资企业在东南亚扩产。

整体而言，产品结构以高多层和HDI为主、客户结构以海外为主、面向服务器及周边产品和汽车电动化智能化相关的公司经营表现更好。展望2025年，全球PCB行业仍将进一步复苏，AI、网通、卫星通信等行业仍将面临高景气，与之配套的高多层高速PCB、HDI等产品仍将面临较好的市场前景；常规多层PCB领域面临的内卷格局会有所缓和；封装基板行业仍将持续复苏，AI仍是核心驱动力，存储行业复苏和消费电子行业需求回暖也将提供助力。面临的挑战之一是关税政策对于整体供应链和需求的影响尚有待观察，另一方面是黄金价格大涨以及铜价维持高位造成的成本压力。

三、FCBGA封装基板项目的进展情况

截至目前，公司FCBGA封装基板项目的整体投资规模已超35亿，已完成验厂客户数达到两位数，样品持续交付认证中，良率持续改善中，样品应用领域包括服务器、AI芯片、智能驾驶、交换机晶片、网卡、通信产品等，具体应用视终端客户产品应用而定。该项目已进入小批量生产阶段，未来工作聚焦于市场拓展和量产爬坡，公司已在产能规模和产品良率层面做好充分的量产准备，但受限于行业需求不足、认证周期较长以及订单导入偏慢导致仍未进入大批量阶段，公司将加大市场拓展力度，在全力拓展国内客户的基础上，持续攻坚海外大客户，争取持续的审厂、打样和量产机会，努力把握海外客户供应链本土化的机会，争取2025年完成海外客户产品认证。同时，工厂层面加强成本管控，优化资源配置，持续降本减负。

四、CSP封装基板业务介绍

公司CSP封装基板业务聚焦于存储、射频两大主力方向，并向汽车市

场拓展，产品结构会向高附加值高单价的方向拓展，尤其是多层板难度板，致力于通过优化产品结构增强盈利能力。受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户的份额提升，公司CSP封装基板业务产能利用率逐季提升，整体收入实现较快增长。珠海工厂已启动扩产，预计2025年底前实现3万平/月的产能目标。珠海工厂随着大客户量产导入，有望成为公司新的利润增长点。

五、ATE半导体测试板业务介绍

公司ATE半导体测试板业务平稳发展，剔除Harbor出售影响，2024年营收同比增长超30%，毛利率同比提升较大，保持较好的盈利能力和发展势头。良率、准交率和客户满意度持续提升，30层及以上高阶产品的占比持续增长，季度间接单规模、大客户份额占比和产值规模持续增长，整体发展前景良好。

六、公司传统PCB业务介绍

报告期内，公司PCB业务实现收入429,969.61万元、同比增长5.11%，毛利率26.96%、同比下降1.76个百分点。

总体而言，公司PCB样板业务维持稳定，PCB多层板量产业务表现落后于行业主要竞争对手。公司已对宜兴硅谷进行调整，并同步导入数字化体系，集中精力优化生产工艺、提升自身良率水平和交付能力，调整客户和产品结构，并加大力度拓展海外市场，争取进一步减少亏损。

七、北京兴斐电子有限公司情况介绍

北京兴斐受益于战略客户高端手机业务的恢复性增长和份额提升，实现收入86,076.46万元、净利润13,619.30万元。北京兴斐HDI板和类载板（SLP）业务稳定增长，除了手机业务以外，2025年重点拓展高附加值的模组基板和光模块业务，以800G光模块为主。

八、关税政策对公司业务影响

公司出口美国和加拿大的收入占比较低，关税政策总体对公司业务影响不大。PCB样板和半导体测试板业务公司相比美国本土PCB厂商更具价格优势和交付优势，从整体竞争力角度而言有助于公司开拓海外客户。公司今年已成功进入北美大厂供应链，交付了PCB样板和半导体测试板，实现了从零到一的突破。

附件清单

无

日期	2025年4月25日
----	------------